

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

- М. Гольцова.** Конференция IEDM 2012.
Не так сложно создать новый прибор,
как отказаться от старого №1, с.138
- И. Шахнович.** Electronica 2012: штрихи
монументального полотна №1, с.146
- А. Семенова.** ЭкспоЭлектроника – как она есть №2, с.28
- А. Якунин.** Итоги деятельности радиоэлектронной
промышленности в 2012 году и основные задачи
на 2013 год №3, с.22
- Совещание руководителей предприятий
радиоэлектронной промышленности №3, с.28
- И. Романова.** Точные измерения – основа качества
и безопасности. IX Московский международный
форум №5, с.162
- И. Романова.** Отечественная СВЧ-электроника.
70 лет развития. По материалам конференции №6, с.122
- В. Беляев.** Международный симпозиум "Передовые
дисплейные и световые технологии" (ADLT-13) №6, с.130
- И. Кокорева.** VII Московский международный
LED-форум. Развитие светодиодных технологий №7, с.128
- И. Шахнович.** Вы говорите на LabVIEW?
Конференция National Instruments Week 2013
как зеркало новой индустриальной революции №8, с.58
- И. Кокорева.** Светодиодные технологии в мире и в России
VII Московский международный LED-форум №8, с.74

ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

- А. Шокин.** Неисчерпаемый электронщик.
Памяти В.М.Пролейко №5, с.150

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

- М. Берман.** Модули питания – как выбрать
радиатор охлаждения №5, с.114
- М. Берман.** Два в одном – источники питания PFE
компании TDK-Lambda №6, с.98
- М. Шейкин.** Электромагнитная совместимость
источников вторичного питания.
Фильтрация и модульные решения №6, с.102
- А. Федоров.** Профессиональные источники
питания Delta Elektronika. Возможности внешнего
управления №7, с.40
- А. Телегин.** Производительная система питания
APS – широкие возможности для тестирования
электронного оборудования №7, с.46

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

- А. Трошин.** Наша специализация – создавать
научеёмкие производства №1, с.12
- А. Блюдов.** Принципы логистики: быстрее, лучше,
дешевле №1, с.26
- А. Разоренов.** Чтобы быть успешным, нужно
работать на опережение №2, с.12

- С. Лукачев, Д. Власов.** Сотрудничество, выгодное
для всех. Итоги года совместной работы ПК
"Альтоника" и ГК "ДИАЛ Электролюкс" №2, с.158
- С. Тихонов.** Технологическое оборудование
под требования заказчиков? Это к нам! №3, с.12
- С. Лукачев.** Мы поможем российским фирмам
закрепиться на международном рынке №3, с.142
- Н. Меркушкин.** Инновации и инвестиции –
две главные задачи №4, с.12
- Г. Кён, Д. Ким.** Точнее, современнее, дешевле №4, с.131
- П. Шатэн.** iipeo – интеллектуальность
и универсальность №4, с.134
- В. Верба.** Концерн "Вега": искусство возможного №5, с.10
- Е. Назаров.** Технология "микроузлы на плату".
Путь к надёжной и дешевой радиоэлектронике №5, с.205
- Г. Коршунов.** Компания "ПАНТЕС": когда качество
поставлено на поток №5, с.214
- А. Мешер.** Renesas Electronics – перезагрузка? №6, с.10
- Д. Курран.** Развитие электроники глазами лидера
средств электронных измерений №7, с.12
- А. де Джис.** Инновации начинаются
с безумных идей №8, с.10
- А. Якунин.** Актуальные вопросы развития
радиоэлектронной промышленности №8, с.22
- И. Шахнович.** Актуальные вопросы развития
радиоэлектронной промышленности. 12-я Отраслевая
конференция радиоэлектронного комплекса России №8, с.30

КОМПЬЮТЕРЫ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

- М. Шейкин.** Российские суперкомпьютеры.
Три года прогресса №1, с.76

СВЯЗЬ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

- Н. Варава, С. Пронин, М. Никоноров.** Активные
компоненты ВОЛС для систем с пакетной передачей №4, с.74
- Н. Варава, М. Никоноров, С. Пронин.** Активные
компоненты волоконной оптики в системах
управления технологическими процессами №7, с.86
- М. Шейкин.** Российские суперкомпьютерные
технологии проблемы и перспективы №8, с.114

КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЯ

- Д. Курран.** Новый анализатор спектра – работа
в реальном времени и уникальные характеристики №1, с.112
- С. Корнеев.** Новые частотомеры серии АК ИП ЧЗ-85 –
быстрее, функциональнее, точнее №1, с.120
- Р. Руиз, М. Хеллвиг.** Программный I/Q-интерфейс
осциллографа R&S RTO – широкие возможности
для анализа сигналов №2, с.102
- А. Шиганов.** Биполярные источники питания
АКИП – эффективный инструмент для производства
и исследований №2, с.116

А.Насонов. Электрическое тестирование. Что, как и зачем?	№3, с.102
С.Корнеев. ВЧ-вольтметр АК ИП-2403 – высокая точность и многофункциональность	№3, с.108
Н.Елисеев. R&S SMW200A. Изящное искусство генерации сигналов	№4, с.90
А.Шиганов. Источники питания АК ИП-1107/1107A. Моделирование параметров бортовой электрической сети	№4, с.98
В.Майская. Автоматические тестовые системы. Что ожидать в 2013 году?	№5, с.36
Н.Клюквин. Введение в технологию периферийного сканирования. Описание и рекомендации для разработчиков	№5, с.48
Д.Серков. GDS-72000 – больше, чем осциллограф	№5, с.60
М.Кашапов. Комбинированные испытательные установки – как сделать правильный выбор	№5, с.64
Р.Шарипов. Контроль и прогнозирование надежности реле. Автоматизированный тестер FORMULA R	№5, с.68
С.Скворцов. Новые источники-измерители серии 2600 компании Keithley	№6, с.86
А.Шиганов. Осциллографы LabMaster 10 Zi: превосходные характеристики и гибкость конфигурации	№6, с.90
А.Шиганов. Программируемый источник питания РРН-71503 – быстрый, точный и универсальный	№7, с.94
Н.Лемешко. Осциллографы Rohde&Schwarz – анализ электромагнитной совместимости	№7, с.100
Новинки Agilent Technologies №1, с.116; №2, с.114, №3, с.100; №5, с.76; №6, с.94; №8, с.148	
Ф.Берту. Контрольно-измерительное оборудование – какой форм-фактор выбрать?	№8, с.152
Н.Лемешко. Осциллографы R&S RTO – эффективный инструмент для анализа целостности сигналов	№8, с.154
А.Шиганов. Мультиметры GDM-78340 компании GW Instek. Высокая точность и многофункциональность	№8, с.162

МЕДИЦИНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

И.Романова. Медицина будущего – цифровая медицина. По материалам конференции "Здравоохранение и технологии 2012"	№1, с.106
---	-----------

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ И МИКРОПРОЦЕССОРЫ

Н.Королев. Микроконтроллеры Atmel на ядре Cortex. Расширение семейства	№1, с.68
Н.Захаров, В.Клепиков, Д.Подхватилин, Д.Семикин, А.Шепелев. СнК "Миландр" в распределенных сетевых системах управления для ответственных применений	№4, с.64

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Млечный путь-2: made in China. Опубликовано 41-я редакция TOP500	№4, с.22
А.Амосов, Н.Плискин. 32-разрядный микроконтроллер 1986BE1T. Применение в бортовых автономных системах безопасности полета	№6, с.82

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Оборудование и персонал. Подходят ли они друг другу?	№2, с. 22
Что будущее нам готовит? Новые технологии в мире и в России	№3, с.48
Рынок микроконтроллеров. Как выбрать и не утонуть?	№4, с.30
Контрольно-измерительное оборудование. Собственное или общее?	№5, с.32
Банки и производство – как стать полезными друг другу?	№6, с.30
Источники вторичного питания. Что впереди?	№7, с.30
Светодиодные системы освещения. Конъюнктурный тренд или реальная экономия?	№8, с.54

НОВОСТИ

№1, с.36; №2, с.36; №3, с.40; №4, с.24; №5, с.28; №6, с.22; №7, с.24; №8, с.44
--

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Н.Павлов. Солнечная энергия – энергия будущего. №1, с.130	
М.Гольцова. Литография с использованием жесткого УФ-излучения. Быть или не быть?	№3, с.54
Т.Ершова. Электромагнитная изоляция узлов электронных приборов. Полимерные композиционные и компаундные материалы	№3, с.64
Д.Красовицкий, А.Филаретов, В.Чалый. Стандартизованные процессы производства нитридной СВЧ ЭКБ. Состояние и ближайшие перспективы	№3, с.70
Н.Латухина, В.Чепурнов, Г.Писаренко. Новые перспективы старых материалов: кремний и карбид кремния	№4, с.104
И.Волков. Электроника на пластике. Возвращение	№6, с.198
А.Ефремов, А.Нисан. Задельные технологии. Развитие печатной электроники	№7, с.108
М.Шейкин. Первая российская конференция 3D-MID. Обзор основных тем	№8, с.138

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

И.Олихов, Г.Столяров, В.Степанов. Лазерные курсоглиссадные системы посадки воздушных судов	№5, с.124
---	-----------

РЫНОК ДИСТРИБУЦИИ

- И.Шахнович, О.Саликова.** Глобальные дистрибьюторы – многоликое единство №3, с.114
- Д. Велеславов.** Компания "Макро групп" стала официальным дистрибьютором Xilinx в России №4, с.34
- К.Шамков.** Future Electronics: когда компоненты нужны вчера №6, с.34
- А.Салончик, М.Гурбашков.** Авитон: больше, чем просто дистрибьютор №7, с.32
- А.Харабжиу.** Источники питания компании AMETEK Programmable Power – уже в России №7, с.114

СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОТЕХНИКА

- И.Романова.** Светодиодная продукция компании OSRAM Opto Semiconductors №8, с.100

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

- Я.Эйни.** TDK-Lambda: бизнес в России неуклонно расширяется №1, с.30
- А.Федоров.** Лабораторные источники питания Delta Elektronika B.V. Обзор продукции №2, с.120
- М.Шейкин.** Источники питания и изолирующие усилители Mornsun. Рекомендации по выбору и применению №4, с.82

СВЯЗЬ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

- С.Дингес, Е.Хасьянова.** Многолучевые антенны: решения компании ETI №2, с.106
- Жоюю Пи, Фарук Хан.** Введение в широкополосные системы связи миллиметрового диапазона №3, с.86

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- Дж.Чилтон.** Доверьте нам свое будущее №1, с.94
- С.Лузин, С.Попов, Ю.Попов.** Гибкая топологическая трассировка в произвольных направлениях. Особенности и преимущества №1, с.96
- А.Сэттон.** Ошибок не будет. Умные технологии логического синтеза и отладки №2, с.126
- А.Сабунин.** Работа с ПЛИС в Altium Designer. Функциональное моделирование №2, с.136
- А.Сергеев.** Моделирование электронных схем в OrCAD EE Designer. Руководство для начинающих ... №5, с.118
- К.Брок.** Оптимизация основных элементов систем на кристалле. Достижение максимальной производительности и минимального энергопотребления №6, с.146

СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

- В.Беляев.** Светодиоды и плоскочелюстные дисплеи. Совмещение несовместимых №8, с.82
- С.Антонов.** Малогабаритные дисплеи для вывода текстовых сообщений №8, с.96

ТЕМА ГОДА: МЭМС

- В.Майская.** МЭМС-технология завоевывает новые рубежи №1, с.183
- Д.Урманов.** Концепция развития производства МЭМС-изделий в России на период до 2017 года №1, с.192
- МЭМС-форум 2012 "Моделирование. Производство. Тестирование" №1, с.200**
- Е.Шульцева.** РАМЭМС приняла участие в конференции MEMS Executive Congress US 2012 №1, с.204
- А.Бекмачев.** Пороговые датчики движения SignalQuest. Шедевр микромеханики №1, с.206
- Д.Льюис, П.Шрейер.** Новые МЭМС-микрофоны Analog Devices – рекордно низкий собственный шум №1, с.210
- И.Бармашов.** Плазмохимическое травление в технологии изготовления МЭМС-датчиков №2, с.143
- О.Болдова.** Бизнес-тур российской делегации по предприятиям французской Кремниевой долины №2, с.146
- О.Болдова.** Современные программные продукты фирмы Coventor для моделирования МЭМС-устройств №2, с.147
- В.Шурьгина.** В поисках стандартов МЭМС. Фермеры против ковбоев №3, с.119
- Международный МЭМС-форум 2013 №3, с.127**
- Д.Урманов, О.Болдова.** Беспроводные сенсорные системы для обеспечения безопасности подвижных и неподвижных объектов №3, с.128
- Е.Борисов.** Микроэлектромеханические системы. Настоящее и будущее №4, с.111
- РАМЭМС на саммите в Шанхае №4, с.115**
- А.Тюрин, И.Калапышина, М.Вьюгин.** Акселерометры Analog Devices – исследование вибраций в трибоконтакте №4, с.116
- В.Шурьгина.** Медицинские МЭМС. Доктор в кармане №5, с.169
- А.Нисан.** Микрофлюидные модули: области применения и технологии производства №5, с.182
- А.Григорьев.** МЭМС-датчики дифференциального давления серии LVA. Высокая надежность, малые габариты №5, с.198
- М.Гольцова.** Перспективы развития МЭМС. Интенсивный рост, новая движущая сила №6, с.113
- М.Гольцова.** МЭМС-устройства аккумулирования энергии. Сбудутся ли мечты? №7, с.117
- В.Майская.** Электроника 2013 года. Двенадцать ведущих МЭМС-друзей №8, с.171

ЭКОНОМИКА+БИЗНЕС

- В.Кочемасов, Е.Строганова.** Электронные компоненты иностранного производства. Ограничение экспорта в Россию №1, с.124
- В.Корчак, Е.Тужиков, Л.Бочаров.** Американская программа "Критические военные технологии" Характеристика и анализ содержания №5, с.134

П.Козлов. Тонкая работа. Производство высокотехнологичной металлокерамики №8, с.166

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ЭЛЕКТРОНИКИ

В.Шурыгина. АЦП всякие важны. АЦП всякие нужны №1, с.46

П.Чуприна. АЦП и ЦАП компании Maxim для прецизионных измерительных устройств. Малое энергопотребление и высокая интеграция №1, с.56

К.Макарова. Высокоскоростные АЦП и ЦАП компании NXP для радиочастотных устройств №1, с.64

М.Гольцова. Энергонезависимая память сделана из того, сего и еще чего-то. По материалам конференций IEDM 2012 и ISSCC 2013 №2, с.42

П.Чуприна. Программируемая логика. Actel и Atmel не уступают своих позиций №2, с.58

Н.Ермошин. ПЛИС XILINX. Чем ее "шить"? №2, с.64

В.Комиссаров. Микроконтроллеры компании "Миландр" – эффективное средство программирования ПЛИС №2, с.70

У.Мунир, Д.Кэнни. Аналоговые КМОП-ключи. Руководство по выбору №2, с.76; №3, с.76

Н.Егоров. Циркуляторы и вентили ВЧ- и СВЧ-диапазона – решения компании DiTom Microwave №2, с.94

А.Бекмачев, К.Солинский. Датчики Meggitt. 150 лет в экстремальных условиях. Часть 2 №2, с.98

Н.Скрипкин. Магнетроны 2- и 3-мм диапазонов. Новые разработки и перспективы их использования №3, с.90

А.Багдасарян, С.Багдасарян, Г.Кашенко, С.Николаева, Р.Семенов. Система автоматической идентификации управления перемещением грузов на железнодорожном транспорте №3, с.92

М.Шурыгина. Юбилейная конференция ISSCC. Просто о процессорах №4, с.36

И.Романова. Развитие семейств МК LPC1100 и LPC1300 компании NXP. Снижение энергопотребления №4, с.50

П.Чуприна. Микроконтроллеры с пониженным энергопотреблением. Новые продукты компании Maxim Integrated №4, с.58

И.Романова. Развитие семейств микроконтроллеров LPC1700, LPC1800, LPC3000, LPC4300. Повышение быстродействия №5, с.80

А.Андросов, К.Джурицкий. Герметичные СВЧ-вводы для микроэлектроники. Электрические параметры и методика их измерения №5, с.84

М.Самойлова. Модульные разъемы компании ODU в системах диагностики и контроля №5, с.94

В.Кочемасов, С.Хорев. Продукция компании Ion Beam Milling. Краткий обзор №5, с.102

Н.Варава, М.Никонов, С.Пронин. Активные компоненты ВОЛС для обработки сигналов произвольной длительности №5, с.108

В.Майская. На пути к достижению субмиллиметрового диапазона длин волн №6, с.44

А.Харитонов. Беспроводные технологии компании Cisco. Точки доступа Aironet №6, с.60

А.Андросов, К.Джурицкий. Герметичные СВЧ-вводы для микроэлектроники. Зарубежная и отечественная продукция №6, с.64

М.Самойлова. Цилиндрические разъемы компании ODU с защелкой для изделий специального назначения №6, с.74

М.Ермаков. Тиристорные модули для плавного пуска двигателей. Тепловой расчет №7, с.52

И.Романова. Силовые конденсаторы компании Ducati Energia №7, с.64

Д.Сикрест, П.Сиддл, А.Любышев, Г.Кон. RF Micro Devices для российского рынка: движимые к соединению №7, с.72

Д.Колесников, А.Однолько, Е.Сухотерин, К.Фролов.

Стабилизаторы со сверхнизким падением напряжения. Микросхемы ЗАО "ПКК Миландр" 1309EP1T и 1309ENXX №7, с.80

С.Харрис. В Россию с любовью: Imagination Technologies + MIPS = ? №8, с.122

А.Багдасарян, Т.Синицына, О.Машинин, П.Иванов, Р.Егоров. Устройства частотной селекции на ПАВ в современных системах связи, радиолокации и телекоммуникации №8, с.128

ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ РЕПОРТАЖ С ПРОИЗВОДСТВА

Современное производство – какое оно? Визит в корпорацию

"Дженерал Сателайт" №1, с.149

Мы выбрали Mirae – и не пожалели. Визит в компанию "Энфорсис" №2, с.135

Когда планирование охватывает все. Визит в НПП "Итэлма" №3, с.121

Производительность, гибкость, надежность. Визит на Петушинский

металлический завод №5, с.153

Сложность, ответственность, качество. Визит в компанию "Эрикон" №6, с.129

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

А.Сабунин. Altium Vault. Первое знакомство №2, с.150

А.Сабунин. Altium Designer 13.3. Новые возможности №3, с.138

А.Сабунин. Altium Vault Server. Управление проектами №5, с.178

С.Попов, Ю.Попов. Выравнивание задержек сигналов. Проблемы и решения №5, с.184

ОБОРУДОВАНИЕ

А.Петров, А.Савельев. Автоматизация нанесения двухкомпонентных смесей. Залог повторяемости и качества заливки №4, с.230

ТЕХНОЛОГИИ

С.Шихов. Печатные платы с повышенными требованиями к надежности. Вопросы проектирования....№1, с.164

Е.Назаров. Монтаж "микроузлы на плату" – развитие технологии "системы в корпусе"..... №1, с.170

В.Сокол, А.Турцевич, А.Белоус. Перспективы использования алюминиевых оснований в СВЧ-устройствах..... №1, с.174

А.Абдуллаев. Проблемы проектирования печатных плат, влияющие на качество автоматического монтажа. Варианты решения..... №1, с.180

В.Лысов. Второе десятилетие ЗАО "НПФ "Доломант" Итоги подводить рано..... №1, с.186

Ю.Богданов, В.Кочемасов, Е.Хасьянова. Фольгированные диэлектрики – как выбрать оптимальный вариант для печатных плат ВЧ/СВЧ-диапазонов. №2, с.156; №3, с.142

И.Волков. Технология 3D-MID. Новые возможности прототипирования изделий..... №2, с.170

В.Ланин, И.Сергачев. Индукционный нагрев улучшает качество паяных соединений шариковых выводов BGA.. №2, с.176

М.Шейкин. Проектирование и монтаж печатных плат повышенной надежности. Некоторые "подводные камни" №2, с.182

В.Ланин, В.Парковский. Конструкции электронных модулей. Оценка устойчивости к механическим воздействиям №3, с.148

М.Шейкин. Не оловом единым. Технологии и свойства современных финишных покрытий печатных плат..... №3, с.154

А.Савельев. Отмывка печатных плат Современные альтернативы изопропанолу, этанолу и спиртобензиновой смеси №3, с.164

А.Кучерявый. Интерактивный прорыв. Диалог заказчик/исполнитель №4, с.220

А.Маурин, Р.Фабер. Пайка компонентов в корпусах QFN. Методы борьбы с пустотами №5, с.164

А.Ефремов. От анализа к контролю. Стратегия качества сборки печатных узлов..... №5, с.170

М.Кашапов. Электронные компоненты с повышенной чувствительностью к влажности. Требования при работе..... №6, с.138

А.Вотинцев. Электростатическая защита на предприятиях. Теория и практика №6, с.142

А.Евсенийкин. Пайка с двух рук. Повышение качества ручного монтажа №6, с.158